

Features

- ▶ 低コスト製品向けのCuまたはAgワイヤ接続
- ▶ JEDEC標準パッケージアウトライン
- ▶ ストリップテストを含むターンキーテストサービス
- ▶ グリーンマテリアル標準 - PbフリーおよびRoHS準拠

Process Highlights

- ▶ ウェハバックグラインディング対応
- ▶ マルチチップ、チップスタック対応
- ▶ ダイアタッチフィルムおよびInner Lead Trace (ILT) リードフレームを用いたチップオンリード (COL) 対応
- ▶ 無光沢Snリード標準
- ▶ パッケージレーザーマーク

TSOP

TSOP (Thin Small Outline Package) は、SRAM、FLASH、FSRAM およびEEPROMなどのメモリ製品に適したリードパッケージです。環境に配慮したグリーンマテリアルを標準として使用し、PbフリーおよびRoHS基準に準拠しています。

Reliability Qualification

Amkorのパッケージ認定試験では、3つの別々の製造ロットと、テストグループ当たりMin77pcsの製品を使用します。すべての検査にはJSTD-020に準拠した前処理が含まれます。

- ▶ MSL特性 : JEDEC Level1, 85°C/85% RH, 168 hours
- ▶ uHAST : 130°C/85% RH, No bias, 96 hours
- ▶ 温度サイクル : -65°C/+150°C, 500 cycles
- ▶ 高温保管 (HTS) : 150°C, 1000 hours

Services and Support

Amkorは、お客様に高品質な製品を迅速かつ低コストで市場に投入していただくためのサポートをする幅広いリソースをご用意しています。

- ▶ カスタムリードフレームデザイン
- ▶ すべてのパッケージ特性評価に対応
- ▶ 熱特性、機械的ストレスおよび電気的性能のモデリング
- ▶ ターンキーアセンブリ、テストおよびドロップシップ
- ▶ ワールドワイドレベルの信頼性検査と不良解析

Test Services

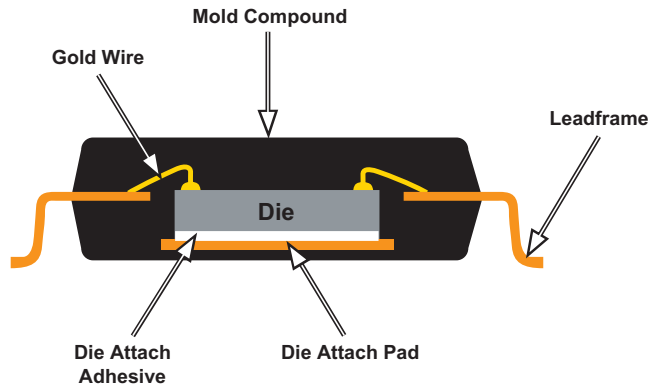
- ▶ プログラム作成/コンバージョン
- ▶ ウェハプローブ
- ▶ パーンイン対応
- ▶ -55°C~+165°Cテスト対応

Shipping Options

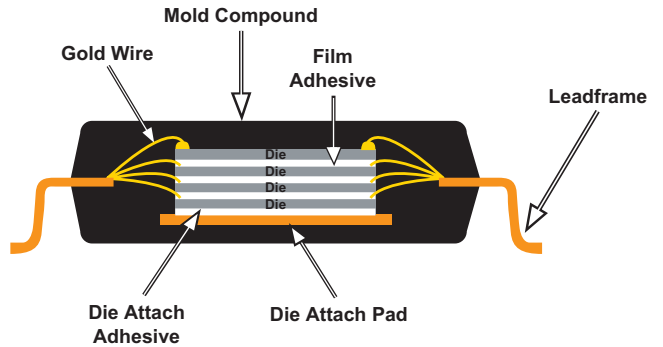
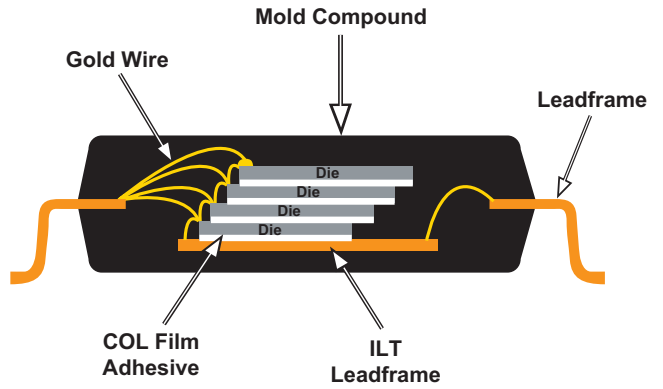
- ▶ JEDECトレイ CS-020
- ▶ バーコード
- ▶ ドライパック
- ▶ ドロップシップ

TSOP

Cross Section TSOP



Cross Section Stacked TSOP



Configuration Options

TSOP Nominal Package Dimensions (mm)

Package Type	Lead Count	Body Width	Body Length	Body Thickness	Overall Height	Lead Pitch	Tip-to-Tip	JEDEC
TSOP 1	48	12.00	18.40	1.0	1.1	0.50	20.00	MO-142



詳細についてはamkor.comにアクセス、またはsales@amkor.com までメールをお送りください。

本文中の情報に関して、Amkorはそれが正確であることまたはかかる情報の利用が第三者の知的権利を侵害しないことについて、いかなる保証もしません。Amkorは同情報の利用もしくはそれに対する信頼から生じたいかなる性質の損失または損害についても責任を負わないものとし、また本文書によっていかなる特許またはその他のライセンスも許諾しません。本文書は、いかなる形でも販売の標準契約条件の規定を超え、いかなる製品に対しても、Amkorの保証を拡張させ、または変更することはありません。Amkorは通知することなくいつでもその製品および仕様に変更を行う権利を留保します。Amkorの名前とロゴはAmkor Technology, Inc.の登録商標です。記載されている他の全ての商標はそれぞれの会社の財産です。

© 2019 Amkor Technology Incorporated. All Rights Reserved. DS330L Rev Date: 05/19